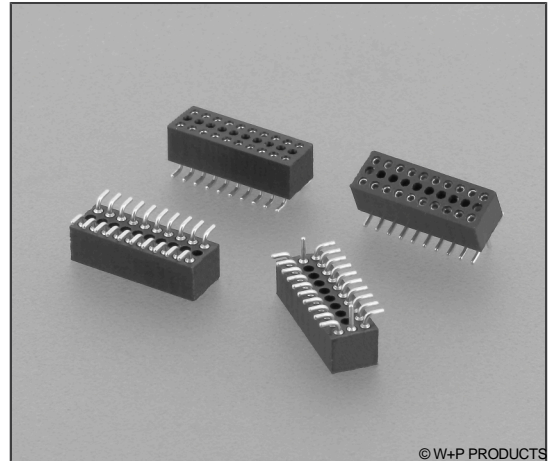


## SMT-Präzisions-Buchsenleisten RM 1,27x2,54mm, stehend SMT Precision Female Headers, 1.27x2.54mm Pitch, Vertical

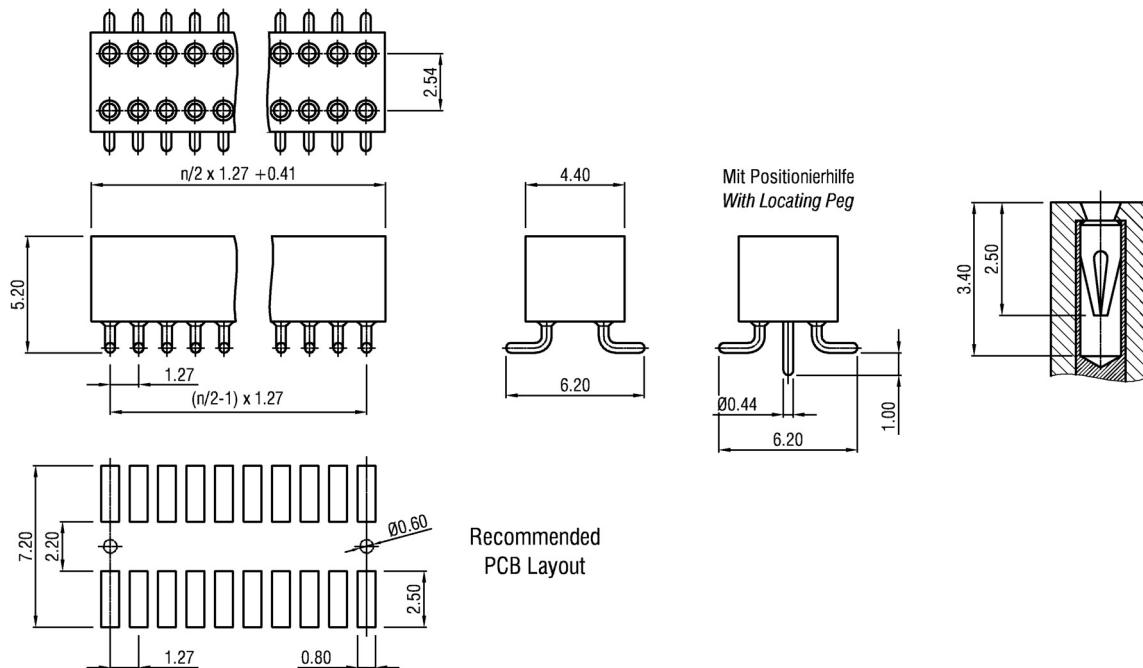
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Hülse: Messing gedreht Feder: 3-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer <i>Sleeve: screw machined brass Clip: 3-Finger-Clip, Beryllium-Copper</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ <i>&lt; 20 mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ <i>&gt; 1000 MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V RMS <i>500 V RMS</i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	100 V RMS / 150 V DC <i>100 V RMS / 150 V DC</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1 A <i>1 A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55 °C ... +125 °C <i>-55 °C ... +125 °C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Einsetzbar für Rundstifte Ø0,35-0,50mm  
und Vierkantstifte 0,5x0,25mm.  
*Mates with Ø0.35-0.50mm round pins  
and 0.5x0.25mm square pins.*



<b>Series</b>	<b>Contacts*</b>	<b>Sleeve Plating</b>	<b>Clip Plating*</b>	<b>Locating Pegs*</b>	<b>Packaging*</b>
<b>1552</b>	<b>010</b> 004-100 Zweireihig <i>Double row</i>	<b>50</b> 50 Hülse verzinnt <i>Tin plated sleeve</i>	<b>00</b> 00 Feder vergoldet <i>Gold plated clip</i> <b>10</b> Feder 0,25µm Gold (Option) <i>0.25µm gold plated clip (Option)</i> <b>30</b> Feder 0,75µm Gold <i>0.75µm gold plated clip</i>	<b>10</b> 00 Ohne Pos.hilfen <i>W/o loc. pegs</i> <b>10</b> Mit Pos.hilfen <i>With loc. pegs</i>	<b>ST</b> ST PPST PPTR (Option)

### Lieferformen / Packaging Options:

**ST** In Stangen ohne Pick&Place-Pads / *In tubes w/o Pick&Place-Pads*  
**PPST** In Stangen mit P&P-Pads / *In tubes with P&P-Pads*  
**PPTR (Option)** Tape & Reel mit P&P-Pads / *Tape & Reel with P&P-Pads*

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

## Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150 °C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217 °C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$	max. 8m

### Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150 °C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217 °C
Duration above $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature $T_P$	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	max. 8min

